

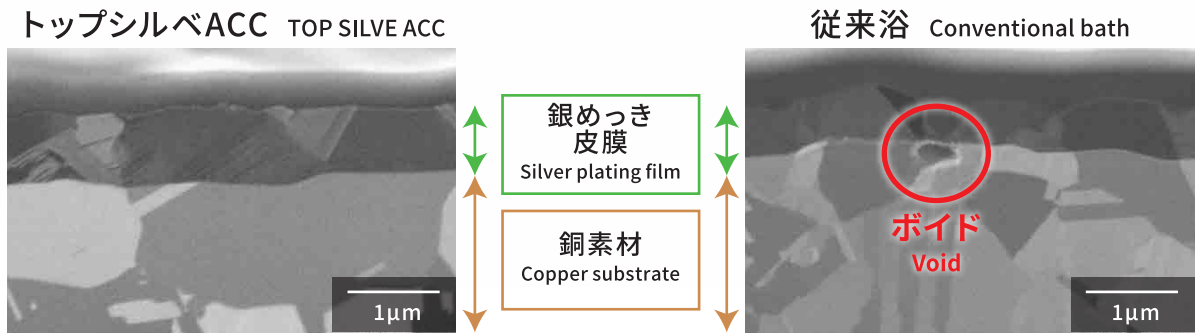
銅上の無電解銀めっき液
Electroless Ag Plating Process on Cu

トップシルベACC

TOP SILVE ACC

- 銅素材上に無電解銀めっきが直接でき、ナノ銀焼結接合用の下地として使用可能
Can make electroless silver plating directly on copper substrates, can use as undercoat for nano-silver sintering bonding
- 下地銅の腐食が少ない
Can reduce corrosion on base copper
- 密着性およびファインパターン性に優れる
Great adhesion, fine pattern ability

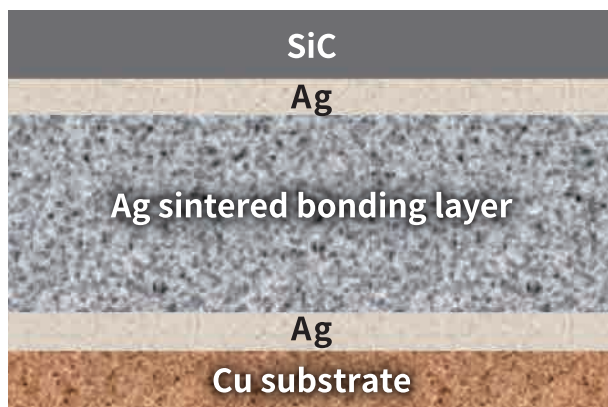
下地の腐食が少ない Can reduce corrosion on base copper



密着性およびファインパターン性に優れる Great adhesion, fine pattern ability



ナノ銀焼結接合用途
Application: Nano-silver sintering bonding



はんだ接合性に優れる
Excellent solder joint performance

